



中華民國專利證書

發明第 I 696542 號

發明名稱：具有均溫腔的模塑熱傳組件之成形方法

專利權人：慧隆科技股份有限公司

發明人：曾為霖、施養明、許宏源、洪啟航

專利權期間：自 2020 年 6 月 21 日至 2039 年 4 月 23 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



109

年

6

月

21

日

